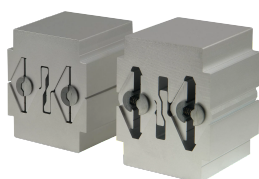


Interscale Flexible Heat Conductor (FHC), 70 mm

Power Utilities



Conductor block expands/contracts vertically to compensate for tolerance stack up and optimizes surface contact and pressure along the thermal path; eliminates the need for a thermal gap pad.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Designed for ATX/ITX/Mini ITX & COM using Intel core-ipcprocessors and AMD processors with the following sockets: Intel: LGA775, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1366,LGA2011 ; AMD: AM2, AM2(+), AM3, AM3(+), FM1, FM2, FM2(+)

Compatible with Interscale C enclosures

Provides industry leading conduction cooling performance, 70% improvement over current conduction cooling methods

Conductor block expands/contracts vertically to compensate fortolerance stack up and optimizes surface contact and pressurealong the thermal path; eliminates the need for a thermal gappad

Secured to PCB with mounting brackets, sold separately

SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Typ	Współpracuje z	Ilość opakowania	Głębokość	Szerokość
------------------	-----	----------------	------------------	-----------	-----------

24830-001	Przewód cieplny	Przypadki	1	50 mm	50 mm
-----------	-----------------	-----------	---	-------	-------

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Please order the mounting bracket (Intel or AMD, listed under accessories) to assemble the FHC to the board.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE